

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2016-002

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

吉林华微电子股份有限公司 关于与北京微电子技术研究所签订战略合作意向协议的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次签订的仅为战略合作意向协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，本次战略合作不存在重大风险。
- 本协议的履行对公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。

一、战略合作意向协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称：北京微电子技术研究所

公司性质：国有制

法定代表人：赵元富

注册资本：9,920 万元

注册地址：北京市丰台区东高地四营门北路 2 号

经营范围：专用集成电路设计测试与封装；集成电路产品试制；集成电路筛选与质量一致性试验；集成电路检测与失效分析；集成电路应用技术开发；相关技术服务与咨询服务。

北京微电子技术研究所隶属于中国航天科技集团公司，是国家重点投资建设的军用电子与器件研制单位，专业从事各种军用/抗辐射集成电路、MEMS 器件和二、三极管的研制，同时提供集成电路封装、测试、可靠性试验、可靠性及失效分析等技术服务。

公司与北京微电子技术研究所不存在关联关系。

（二）战略合作意向协议签订情况

2016年3月11日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与北京微电子技术研究所在吉林省吉林市签订了《战略合作意向协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。

（三）签订战略合作意向协议已履行的审议决策程序

本协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、意向性约定，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关制度的规定，无需提交董事会和股东大会审议。

二、战略合作意向协议的主要内容

（一）合作宗旨

为促进军民融合，进一步提升我国在军事领域功率半导体器件、集成电路、MEMS器件等产品的技术水平，双方自愿结成技术合作伙伴。双方本着平等互利、优势互补的原则，在功率半导体器件、集成电路、MEMS器件等产品的开发应用方面进行合作。

（二）研究内容及分工

1、在军品领域开发军方订单和军方新产品研发任务所涉及的产品型号，双方本着优势互补的原则，分别承担芯片设计、生产制造、封装、测试、销售的任务，并开展业务合作及相应的资源共享、进行必要的技术培训等内容。

2、对有一定批量需求的工业产品，双方本着优势互补的原则，分别承担芯片设计、生产制造、封装、测试、销售的任务，并开展业务合作及相应的资源共享、进行必要的技术培训等内容。

（三）协议生效条件及期限

本协议自双方代表签字盖章后生效，有效期为十年。

三、对上市公司的影响

本意向协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照相关法律、法规的要求开展业务合作；双方本着优势互补的原则，在功率半导体器件、集成电路、MEMS器件等产品的开发应用等方面达成战略合作意向，将利用双方各自优势资源，推动公司产品研发，实现产品升级换代，有利于公司拓展新的业务领域和新的利润增长点，符合公司长远发展需要。

本协议的履行对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、风险提示

本次签署的战略合作协议属于意向性协议，本协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体的实施内容和进度尚待双方沟通并另行签订的实际合同协议为准，尚存在不确定性。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日